

# SOP/TSSOP/QFN28P-DIP28P

## 轉 DIP28P 鍍金轉接板

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### 產品說明

板層：2層板（又稱雙面板或雙層板）正面：QFN28 & SO/SOIC/SOP28 轉 DIP28  
Pitch:0.5mm&1.27mm（引腳間距：SOP 為：1.27mm QFN 為：0.5mm）向下相容，背面：  
MSOP/SSOP /TSSOP28 轉 DIP28 Pitch:0.65mm（引腳間距：TSSOP 為：0.65mm）

板材：FR4 板材（採用 KB 公司軍工級 A 級環保板材，軍工品質）該板材的絕緣性，板材的均勻性，銅皮跟板材基材的可靠性並且銅皮不易縮水，板材的阻抗穩定性

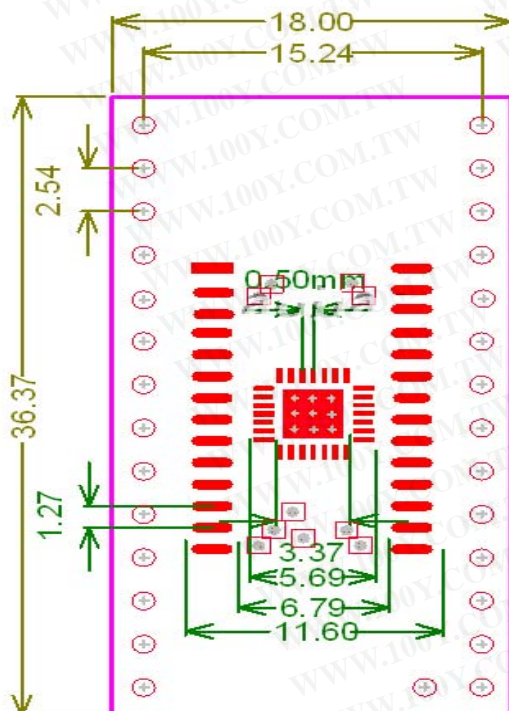
板厚：1.6mm 超厚不易變形

板色：黑油阻焊層與晶片（IC）封裝同顏色更接近晶片封裝

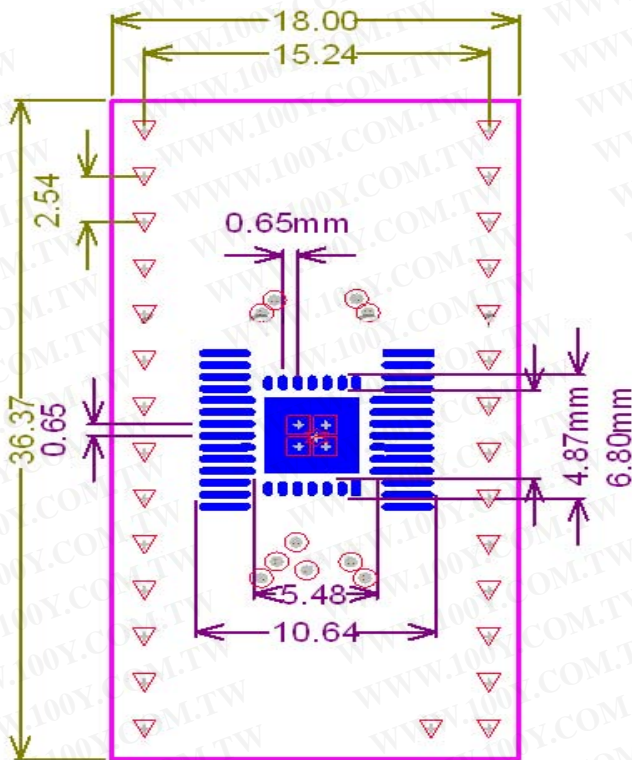
焊盤：採用化學沉金工藝（即焊盤表面鍍金）焊盤與 IC 引腳接觸電阻更小、焊點更牢靠、美觀、防腐蝕、抗氧化、無鉛更環保

### 轉接板正背面尺寸（如下圖）

<正面>：QFN28 & SO/SOIC/SOP28 焊盤間距 Pitch：0.5mm&1.27mm DIP：2.54mm



<背面>：MSOP/SSOP /TSSOP28 焊盤間距 Pitch：1.27mm DIP：2.54mm



【用途】：本轉接板適用於以下“貼片晶片封裝”轉成插件，購買時務必請仔細核對

SO/SOIC/SOP28 轉 DIP28 Pitch：1.27mm 即：焊盤間距離（引腳間距）<焊接位置：轉接板正面>

MSOP/SSOP /TSSOP28 轉 DIP28 Pitch：0.65mm 即：焊盤間距離（引腳間距）<焊接位置：轉接板反面>

QFN28 轉 DIP28 尺寸：Body： Pitch：0.5mm 即：焊盤間距離（引腳間距）<焊接位置：轉接板正面>

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)